

## SE-027 標準作業程序：

1. 刷卡開機。
2. 於機台載台上放置晶圓
3. 踏下腳踏開關
4. 檢查操作側的 VACCUM 是否有-80kpa 以上
5. 選擇晶圓研磨 - 選擇有精修研磨
6. 畫面會跳出輸入 Recipe No.，選擇 1 按下確認
7. 設定目標厚度
8. 確認目標厚度是否正確
9. 確認無誤後按下啟動按鍵
10. 研磨完成結束後選擇晶圓更換與手動踩踏腳踏開關後即可取下晶圓
11. 刷卡關機

### 注意事項

(A)欲自行操作此部設備製前，需先與機台負責人充分溝通，以確保使用中之安全性。

(B)只限使用 Si 基板晶片，其餘一概禁止放入。

(C)所有製程須經儀器負責人同方可使用，若違反上述規定，而造成機台損害者，除停止其使用權利外，並將追究其相關賠償責任。